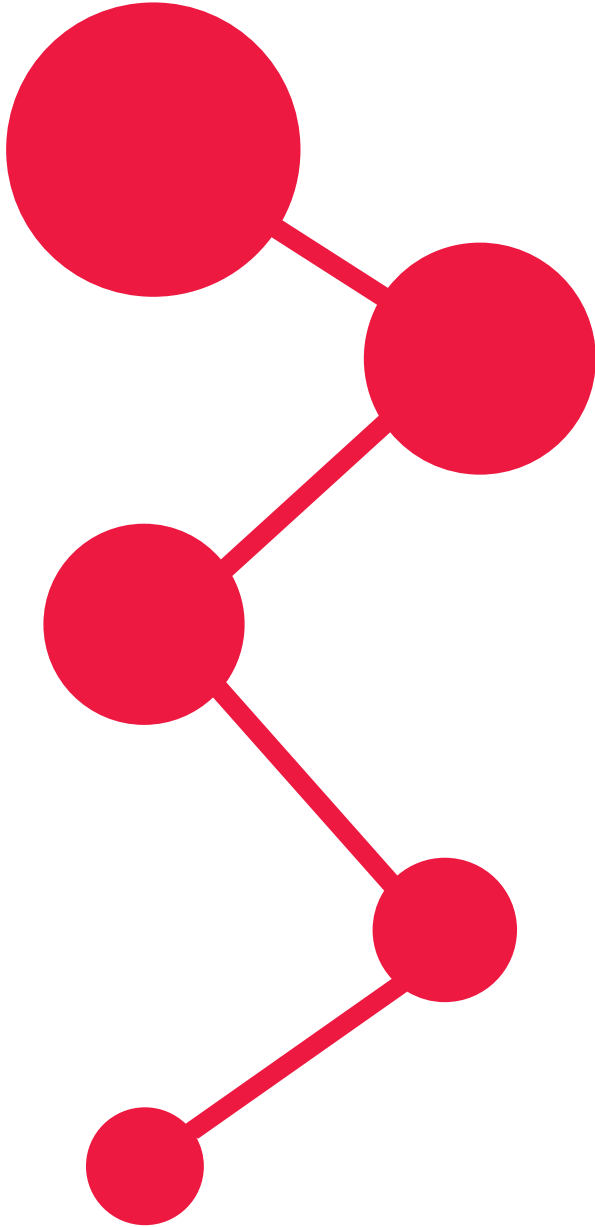




WORLD METAL CO.,LTD.



公 司 简 介

PROFILE OF WORLD METAL

High Technology & Cost Down

不断为您提供最新的表面处理技术

High Technology & Cost Down ——— We continue to offer new surface treatment technology in sequence

WORLD METAL CO.,LTD.(株式会社 世界 金属)是一家从事表面处理技术的研发型公司。

在业界,世界 金属 公司是一家拥有多项高新技术的企业。

迄今为止,我公司研发的新型镀覆工艺,新型镀覆药品为IC, LSI等半导体及电子部件行业的发展做出了巨大的贡献。

镀覆业,是一个跨多学科的由实践经验及知识所构成的领域。

我公司拥有丰富的实践经验及强大的开发能力。诚挚欢迎您与我公司结成商业伙伴。

表面处理领域的专业工程技术人员

"WORLD METAL CO.,LTD." ——— Professional engineers group of the surface treatment industries

扎实的
表面处理领域
专业知识

开发能力

公司
特点

WMF-P
[大幅削减成本]

多样化的
镀覆工艺
& 药品

公司概况

公司名称 WORLD METAL CO.,LTD. (株式会社 世界 金属)

创建时间 1980年2月7日 (创业于1978年)

注册资金 1,000万日元

董事长 林田 英德 (技术士)

董事长 & 执行总裁 林田 洋之

董事 林田 千佳子

林田 国昭

公司总部 日本国大阪府东大阪市今米二丁目一番二十九号

职工人数 50名

业务范围 ① 表面处理用药品的研究, 开发, 生产, 销售

② 新型基质材料用镀覆工艺的开发

③ 镀覆设备, 环保设备的设计, 生产, 销售

④ OEM, 药品的委托生产

⑤ 共同研究与开发


⑥ WMF-process, 镀覆药品的自主化生产

营业所 关东营业所, 东海营业所, Recycling事业部



"WORLD METAL CO.,LTD."





历史沿革
工业专利
主要供应商
开户银行
经营伙伴与
开发领域

历史沿革

1978年 创业
1980年 注册
1987年 开设关东营业所
1993年 开设东海营业所
1999年 完成总公司,技术开发部门,工厂的优化组合(东大阪)
2000年 开设九州营业所
2001年 于韩国开始药品生产
2003年 于台湾,菲律宾开始药品生产
取得 ISO-9001体系认证
2004年 于中国开始药品生产
2005年 完成RoHS指令
2007年 开设驻泰国营业所
导入KES(环境管理系统)系统
2008年 日本经济产业省特别扶助金对象企业

工业专利

日本国及国外共计67件

主要供应商

住友商事,早川商事,日本化学工业,罗地亚集团(日本),BASF,米山药品工业

开户银行

三菱东京UFJ银行,南都银行

WORLD METAL CO.,LTD. 的经营伙伴与开发领域

- ① IC, LSI半导体, 电子部件领域
- ② PCB(印制电路板)
- ③ EMI(电磁波遮蔽)
- ④ 模具, 卷扬设备
- ⑤ 业务设备
- ⑥ 汽车工业
- ⑦ 冶金, 环带, 高炉, 熔炉
- ⑧ 装潢, 显示器
- ⑨ 液晶, PDP, CRT领域
- ⑩ 陶瓷领域

主要药品



- 无电解镀镍药品(Ni-P)
- WMF-process(自行调配)
- 电子元件,PCB,陶瓷制基板上线路用无电解镀镍药品(Ni-P)
- 无铅无电解镀镍药品(Ni-P)
- 电子元件,PCB,陶瓷制基板上线路用无铅无电解镀镍药品(Ni-P)
- 无有害重金属无电解镀镍药品(Ni-P)
- 特别用途无电解镀镍药品(Ni-P)
- 电子元件,线路基板,普通无电解镀镍-硼药品(Ni-B)
- 无铅,无有害重金属,无重金属无电解镀镍-硼药品(Ni-B)
- 特别用途无电解镀覆药品(含钨镀覆,钴合金镀覆)
- 电镀镍用光泽剂
- 特种电镀镍药品
- 无电解镀铜药品,电解镀铜药品
- 无电解镀金药品,电解镀金药品
- 无电解镀银药品,电解镀银药品
- 其他无电解镀覆及电解镀覆用药品
- 无电解镀金设备
- 调节剂,洗涤剂,脱脂剂,辅助剂
- 蚀刻剂(蒸镀膜,膏体,陶瓷,半导体晶片用)
- 蚀刻剂(铜,铁,SUS,钛用)
- 感应材,催化剂(Pd活化剂,触媒)
- 镀层剥离剂(Ni,Au,Sn,焊料)
- 防锈剂,后处理剂,防变色剂
- 电子元件用处理剂
- 特别用途添加剂
- 镀覆绝缘层,掩蔽剂
- 铝材专用药品
- LTCC用前处理工艺
- PCB用药品,CAT-2000-1工艺
- 镀覆工艺,镀覆设备,共同研究,试制加工,金/贵金属的回收再利用



镀覆工艺

- 1 硅片(半导体)基质上的无电解Ni/Au镀覆工艺(生成电极)
- 2 铷-硼-铁(Nd-B-Fe)上的Ni镀覆工艺
- 3 铷-硼-铁(Nd-B-Fe)上的Ni/Cu/Ni镀覆工艺
- 4 铷-硼-铁(Nd-B-Fe)上的无电解镀覆工艺
- 5 铷-硼-铁(Nd-B-Fe)上的高耐腐蚀性,电镀工艺
- 6 高频感应过滤器上的电极生成镀覆工艺
- 7 PZT上的电极生成镀覆工艺
- 8 Cu-W基质上的镀覆工艺(完全无电解Ni工艺)
- 9 (真空)密封(真空终端,石英振子)基质上的无电解镀Ni/Au镀覆工艺
- 10 Al_2O_3 , AlN基质双重膏上的Ni/Au镀覆工艺(陶瓷IC模块)
- 11 Ag, Ag-Pd, Cu膏体印刷线路上的局部选择性Ni/Au镀覆工艺(LTCC基板)
- 12 Ag, Ag-Pd膏体电极上的电解Ni/电解锡镀覆工艺(CR, 芯片电容器)
- 13 Ag-Cu焊盘上的无电解镀覆工艺(科瓦铁镍钴合金/Ag-Cu焊盘)
- 14 异种金属(PGA)基质上的Ni/F-Au/Au镀覆工艺(陶瓷IC模块, W/B-Au)

- 15 半导体电极基板上Ni/焊料(锡铅合金)隆起焊盘的镀覆工艺
- 16 陶瓷,玻璃上Al镀膜上的选择性局部镀Ni/Au镀覆工艺(CAT-92)
- 17 半导体芯片上的超薄隆起UBM工艺(CAT-920)
- 18 铜质引线框上的无电解镀Ni工艺(散热器)
- 19 PCB及Cu质线路板上的局部选择性Ni/Au镀覆工艺(CAT-2000)
- 20 CAT-2500,2500-P(PCB)(Ni/Pd/F-Au,Ni/Pd-P/F-Au)
- 21 CAT-2500,2500-P(LTCC)(Ni/Pd/F-Au,Ni/Pd-P/F-Au)
- 22 Cr-Cu薄膜基质精密线路上的选择性镀Ni/Au镀覆工艺(CAT-99)
- 23 SLC,集成板上的局部选择性Ni/Au镀覆工艺,适用于BGA(CAT-900)
- 24 双重镀镍工艺,强耐腐蚀性
- 25 环箍(钢圈,钢带)基质上的电镀工艺
- 26 不锈钢,超硬质钢(SKD)上的镀覆工艺
- 27 纤维,纺织物及泡沫树脂上的无电解镀覆工艺
- 28 聚酯纤维(塑料)上的镀覆工艺
- 29 微粒(Al_2O_3 , SiO_2 ,云母,钻石,Cu粉,树脂粉)上的无电解镀覆工艺
- 30 玻璃模具上的镀覆工艺
- 31 Ti及Ti合金的基础底层镀覆工艺
- 32 钻石上的复合镀覆工艺(半导体切片锯,钻探机,CMP-Dresser)
- 33 PTFE的复合镀覆工艺
- 34 润滑镀覆工艺(与复合镀覆相异)
- 35 铝质基质上的镀覆工艺(代表性的ADC-12材料上)
- 36 WPC工艺(通孔镀覆工艺)
- 37 TICOMAC工艺(陶瓷基质上的铜质线路)
- 38 陶瓷电容器上的电极生成镀覆工艺
- 39 ACF-工艺(精密细微电铸,微缩现象电成器)
- 40 铬镍铁合金基板上高附着性镀覆工艺(用于铬镍铁合金18)
- 41 快切削基质上的高耐腐蚀性无电解Ni镀覆工艺(碱性前处理,无铬处理)
- 42 锌质压铸件上的电镀工艺(无孔,高耐腐蚀性,高附着性)
- 43 珀尔帖素子上的镀覆工艺
- 44 Be-Cu(镀膜)基质上的各种镀覆工艺
- 45 WMF-process(无电解镀覆药液的自行建浴工艺)

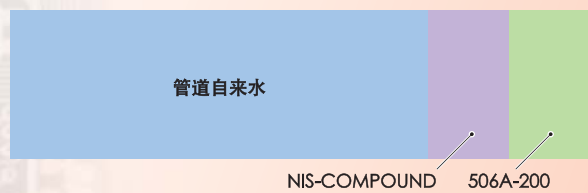
WMF-process (自行调配)

运用我公司的技术在贵公司的工厂内实施无电解镀覆药品的自行调配方法。适用于一定数量以上的药品调制,特别适用于大规模调配,无电解镀镍药液,有利于大幅降低成本。

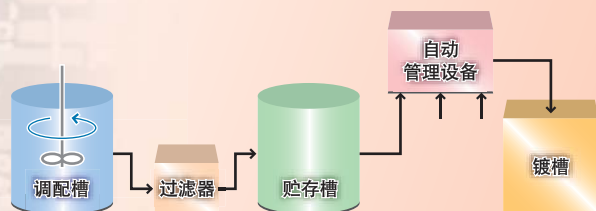
特点


- ➔ 有效削减镀覆成本30-60%
- ➔ 有利于提高贵公司自主技术的研发
- ➔ 可对连锁型公司进行长期供药,以保证品质长期稳定
- ➔ ISO-14001规格环保低污染
- ➔ 发生事故时,及时提出相应的处理方案
- ➔ 有效抑制原料价格的高涨
- ➔ 药品可及时出口
- ➔ 有效降低容器成本
- ➔ 提供详细现场指导

■ 例(LINDEN 506-2 Ni补给液)



■ 工艺设备(补给液 3种→3套系统)





主要销售药品
主要客户

主要销售药品

电解镍(板金,硬币,钢珠),铜板(电解,含磷,OFC),硫酸镍,氯化镍,硼酸,硫酸铜,有机酸(苹果酸,柠檬酸,琥珀酸,乳酸),葡萄糖酸钠,EDTA,罗谢尔盐,氢氧化钠,次磷酸钠,焦磷酸钾

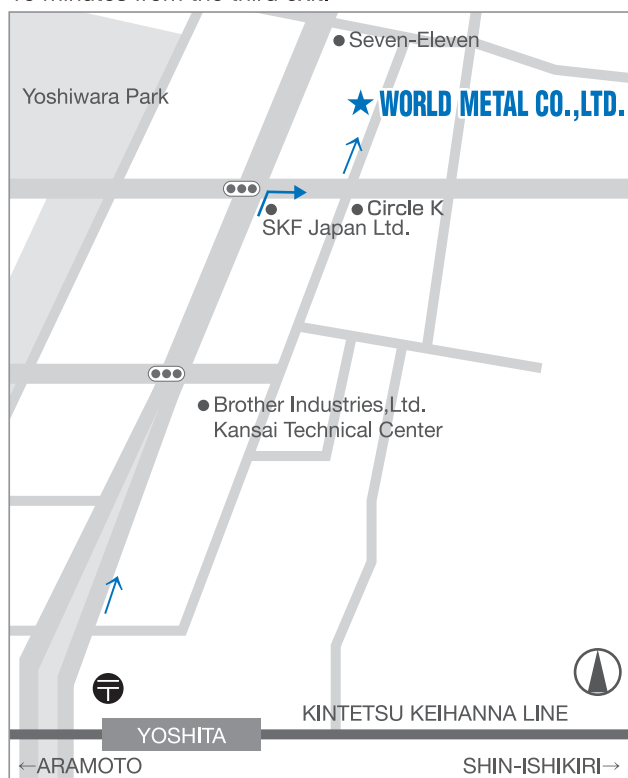
主要客户

Akebono Brake Industry Co.,Ltd.	TORAY Industries Inc.
旭化成	东洋钢板
旭硝子	TOKUYAMA Corp.
Asahi Techno Glass Corporation	TDK
N.E. Chemcat Co.,Ltd.	电气化学工业
大阪大学	DESO Corporation
奥林巴斯	长濑产业
川崎制铁	尼康
佳能	日清纺织
京瓷	日东电工
小糸制作所	Nippon Interphone Co.,Ltd.
神户大学	NGK Insulators,Ltd.
产业综合技术研究所	日本特殊陶业
三洋电机	日本电气
西铁成	日本电气硝子
新光电气工业	日本山村硝子
新日铁	日立金属
Sumiden Fine Conductors	日立制作所
住友金属	Panasonic Corporation
住友电气工业	藤仓化成
Seiko Epson Corporation	富士通
Seiko Instruments Inc.	富士电机
索尼	三菱化学
东芝	三菱电机
TOSOH Corporation	三井物产
TOTO Ltd.	ROHM Co.,Ltd.
	等镀覆行业

OSAKA ACCESS

KINTETSU KEIHANNA LINE [YOSHITA]

10 minutes from the third exit.



株式会社 ワールドメタル <http://www.worldmetal.co.jp>

本社

〒578-0903 大阪府東大阪市今米2丁目1番29号 TEL.072-967-2732(代) FAX.072-967-2809
[統括本部]TEL.072-967-2732(代) FAX.072-967-2809
[技術本部]TEL.072-967-1149(代) FAX.072-967-2559
[製造本部]TEL.072-967-1148(代) FAX.072-967-2558
[営業本部]TEL.072-967-2803(代) FAX.072-967-2809
[海外営業部]TEL.072-967-2803(代) FAX.072-967-2809

関東営業所

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田2-8-28 パストラル飯島202A TEL.046-229-4884(代) FAX.046-229-5123

東海営業所

〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町5丁目98 liberal 901 TEL.0568-33-5600(代) FAX.0568-33-5636

リサイクル事業部

〒179-0084 東京都練馬区氷川台3-29-11ベネ氷川台101 TEL.03-6906-4811(代) FAX.03-6906-4812